

## **Ledia: eccezionale ottimizzazione della luce**

*Ucamco è lieta di annunciare la nuova serie a 3 Lunghezza d'onda dei sistemi Ledia Direct Imaging (DI) per un'esposizione accurata e ad alta velocità dei soldermask più esigenti del settore e dei resist degli strati interno ed esterno.*

Nel campo del direct imaging di materiali PCB, la piattaforma DI LED UV a multi-lunghezza d'onda Ledia di Dai Nippon Screen ha sempre assunto una posizione di leadership. In primo luogo, con i suoi sistemi di imaging Ledia a 2 lunghezze d'onda, Screen ha consentito di raggiungere throughput DI senza precedenti anche sui resist di strati interni ed esterni più esigenti, e ha offerto ai produttori di PCB la prima tecnologia DI con cui elaborare resist di soldermask normali in modo accurato e alle velocità di produzione.

Ora, sulla base di questo successo, Ucamco lancia la serie a 3 lunghezze d'onda di Screen. Questi sistemi a 5 e 6 teste di esposizione combinano emissioni LED ottimizzate a una lunghezza d'onda di 365, 385 e 405 nm nel più potente sistema DI oggi disponibile sul mercato. Grazie ad esso, anche i soldermask più difficili possono essere esposti in modo accurato e affidabile, fino a velocità raddoppiate rispetto alle precedenti, con ottima qualità dei bordi dei deflettori di saldatura e nessun sottosquadro. Anche durante l'elaborazione di strati interni ed esterni, i nuovi sistemi Ledia offrono prestazioni migliorate: linee e spazi da 15 µm con bordi ben definiti e significativi miglioramenti nella produttività.

Il Direct Imaging assume un'enorme importanza nel momento in cui le PCB sono sempre più piccole e sempre più densamente compatte, con componenti e funzionalità di piccole dimensioni. I metodi di esposizione convenzionali semplicemente non possono tenere il passo: le pellicole phototool si spostano con le variazioni di temperatura e umidità, e poiché le dimensioni delle schede si riducono e il lavoro diventa di maggiore precisione, avere le condizioni giuste diventa sempre più dispendioso in termini di tempo, se non impossibile, rendendo la registrazione il più grande collo di bottiglia per molti produttori di PCB, e l'origine di rottami molto costosi.

Ledia elimina i problemi gestendo ciascuna scheda a sé, indipendentemente dalla dimensione delle caratteristiche, da quelle delle scheda o dai volumi di produzione. Michel Van den Heuvel, Imaging Group Director di Ucamco, afferma: "Consideriamo Ledia un'apparecchiatura di registrazione: con il suo sistema di posizionamento in tempo reale integrato e gli algoritmi di allineamento proprietari di Screen, registra automaticamente ogni scheda nell'ordine di pochi micron, eliminando secondi preziosi e, in alcuni rari casi, molti minuti, dal tempo di esposizione necessario per ogni scheda o il pannello".

Le capacità dei soldermask di Ledia la collocano in una classe a sé stante, e, di conseguenza, le vendite sono in rapida crescita, come conferma Van den Heuvel: "In un primo momento, i produttori non potevano credere che i soldermask normali potessero essere elaborati con la tecnologia DI con le velocità e la qualità fondamentali nel nostro settore. Questo perché sono meno fotosensibili dei resist secchi e lo spessore del rivestimento può essere variabile, rendendo difficile eseguire un'esposizione uniforme del resist dall'alto verso il basso. Ma, nel momento in cui abbiamo cominciato a implementare i nostri sistemi a multi-lunghezza d'onda presso produttori di PCB all'avanguardia, la notizia si è sparsa velocemente e le vendite sono decollate". Questa eccezionale tecnologia di riduzione consente a Ledia di migliorare qualità, rese e tempi di consegna. Inoltre, è più economica e le sue sorgenti luminose durano più a lungo e sono meno costose di quelle utilizzate da altri processi di esposizione.

In breve, è anni luce avanti rispetto ad altri sistemi di imaging PCB, e grazie alla nuova serie a 3 lunghezze d'onda, sembra destinata a rimanere, offrendo miglioramenti significativi in termini di qualità, produttività e rese, tutti elementi che influenzano direttamente le entrate. Questo è il motivo per cui i produttori di PCB di maggior successo in Europa stanno scegliendo Ledia.

Perché non unirsi a loro? Contattate Ucamco oggi stesso per scoprire come Ledia possa potenziare il vostro business.

### **Ucamco**

Ucamco (ex Barco ETS) è leader di mercato per il software CAM per PCB, fotoplotting e sistemi di imaging diretto con una rete globale di vendita e centri di assistenza. Con sede a Ghent, in Belgio, Ucamco ha un'esperienza costante di oltre 25 anni per lo sviluppo e l'assistenza di fotoplotter avanzati e soluzioni iniziali di strumentazione per l'intero settore di PCB. Fondamentale per conseguire questo successo è la ricerca da parte dell'azienda dell'eccellenza ingegneristica di tutti i suoi prodotti senza alcun compromesso.



*Per ulteriori informazioni su Ledia, contattare Ucamco:*

**Telefono:** +32 (0)9 216 99 00

**E-mail:** [info@ucamco.com](mailto:info@ucamco.com)

**Sito Web:** [www.ucamco.com](http://www.ucamco.com)